



2022年12月14日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
 (コード番号：6890 東証スタンダード市場)
 問 合 せ 先 I R 室 長 野 田 耕 一
 (0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

連結子会社の増資に伴う特定子会社への異動のお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、当社の中国連結子会社である江蘇富楽華半導体科技股份有限公司（以下、「FLH」）を通じ、FLH の 100%子会社に当たる四川富楽華半導体科技有限公司（以下、「FLHC」）の増資を段階的に実施してまいりましたことにより、FLHC は当社の特定子会社に異動することとなりましたので、以下のとおりお知らせします。

記

1. 増資の背景

- ・当社パワー半導体事業は急速な拡大を遂げており、その生産能力を拡大するため四川省内江市で新工場建設を進めております。FLHC は四川工場の管理・運営を行う会社として本年4月に設立いたしました。
- ・FLHC の資本金は FLH より運営状況に合わせ段階的に出資を行うこととしておりました。今回 11 月 30 日時点でその資本金が 2 億元（約 40 億円）に到達し、当社の資本金の 10%を超え特定子会社に異動することとなりましたため本開示を行うものです。
- ・なお、パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社に関する過去の適時開示経過を<ご参考>「Appendix. I FLH (旧 FTSJ) に関する既往開示内容一覧」に記載しておりますのであわせてご参照ください。

2. 子会社の概要

1) 四川富楽華半導体科技有限公司の概要（2022年9月30日現在）

(1)	名 称	四川富楽華半導体科技有限公司 (FLHC)	
(2)	所 在 地	中国四川省内江市内江経済技術開発区漢晨路 888 号 8 幢	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売	
(5)	資 本 金	130,000 千中国元（約 26 億円） ※ 1 中国元=19.66 円	
(6)	設 立 年 月 日	2022 年 4 月 20 日	
(7)	大株主及び持ち分比率	株主名	持ち分比率
		江蘇富楽華半導体科技股份有限公司 (FLH)	100%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社である FLH が議決権の 60.6%を保有する子会社の 100%子会社
		人 的 関 係	当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

※FLHC は 2022 年中の設立につき、3 カ年の経営成績、財政状態の記載を省略しております。

2) 江蘇富樂華半導體科技股份有限公司の概要 (2022年9月30日現在)

(1)	名 称	江蘇富樂華半導體科技股份有限公司 (FLH)		
(2)	所 在 地	中華人民共和国江蘇省東台市城東新区鴻達路 18 号		
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢		
(4)	事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売		
(5)	資 本 金	379,158 千中国元 (約 75 億円) ※ 1 中国元=19.66 円		
(6)	設 立 年 月 日	2018 年 3 月 16 日		
(7)	大株主及び持ち分比率	株主名	現状	12月増資後
		上海申和投資有限公司 (略称 FTS)	60.6%	55.1%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社である FTS が議決権の 60.6%を保有する子会社	
		人 的 関 係	当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任	
		取 引 関 係	該当事項はありません	

※FLH は 2022 年 11 月 15 日開示「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ (第五回)」のとおり第三者割当増資を実施中です。増資完了は 2022 年 12 月後半の予定です。

3. 増資の前後における FLHC への出資額及び出資総額に対する所有割合

区分	出資額	議決権の所有割合
異動前	130,000 千中国元 (2,556 百万円)	60.6%
異動後 (2022 年 11 月 30 日)	200,000 千中国元 (3,932 百万円)	60.6%

4. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以 上

<ご参考>

Appendix. I FLH (旧 FTSJ) に関する既往開示内容一覧

開示日	表題
2022/11/15	パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第五回)
2022/7/20	パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社における設備投資(新工場建設)に関するお知らせ
2022/5/27	「(開示事項の変更・訂正)パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第四回)」
2022/3/17	「(開示事項の訂正)パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」
2022/3/16	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第四回)」
2022/3/7	「半導体用絶縁放熱基板製造子会社における投資契約締結のお知らせ」
2022/2/25	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による華泰連合証券との上場に関するアドバイザー契約の締結、および 中国証券監督管理委員会による登録のお知らせ」
2021/8/6	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」
2021/4/28	「(開示事項の変更)パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」
2021/4/15	「パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」
2021/3/19	「(開示事項の追加・訂正)パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第二弾)」
2021/2/10	「パワー半導体基板子会社の第三者割当増資に関するお知らせ(第二弾)」
2020/11/17	「パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」

Appendix. II パワー半導体の種類と耐圧・用途

DCB/AMB 主な市場範囲：産業機器、自動車、電気鉄道、再生可能エネルギー

